

## 深圳佰维存储科技股份有限公司

# 关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会 签订项目投资意向协议暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：晶圆级先进封测制造项目一期、二期（以下简称“本项目”）
- 投资金额：预计项目总投资约 30.9 亿元人民币，其中，一期投资额约为 12.9 亿元人民币，其中固定资产投资 12 亿元，一期项目同时作为深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票的募投项目“晶圆级先进封测制造项目”，相关议案已经公司第三届董事会第十次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过；二期投资额为 18 亿元人民币，其中固定资产投资 18 亿元人民币。
- 本次投资项目的投资金额、建设周期等仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
- 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组情形。
- 本事项尚需提交股东大会审议。
- 相关风险提示：
  - 1、本次投资涉及的取得建设用地、施工等前置手续尚未办理，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；
  - 2、本项目是基于公司战略发展的需要以及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性；本项目涉及的建设周期、产能规模等均为初步规划或预测数据，项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，最终实际实

施、生产情况具有不确定性，可能存在未能按期建设完成或未能达到预期收益的风险；

3、芯成汉奇作为本项目经营实体，承担本协议项下的权利和义务。如果芯成汉奇无法履约时，公司须对芯成汉奇违反本协议条款的行为承担补充责任，补充责任以公司对芯成汉奇的持股比例为限；

4、晶圆级先进封测制造项目（一期）为公司 2023 年度拟向特定对象发行 A 股股票募投项目之一，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第三届董事会第十次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过，但尚需经上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。若公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票未获上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会注册通过，本协议项下项目（包含一期、二期）将用公司自有资金或自筹资金进行。

## 一、对外投资概述

### （一）对外投资的基本情况

基于公司的发展战略需要，为把握市场发展机遇，提升公司市场竞争力和综合实力，公司、控股子公司芯成汉奇（作为晶圆级先进封测制造项目一期、二期实施主体），拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订《东莞松山湖高新技术产业开发区项目投资意向协议》。项目总投资额约为 30.9 亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准）。其中一期投资额约为 12.9 亿元人民币，其中固定资产投资 12 亿元，一期项目同时作为公司向特定对象发行 A 股股票的募投项目“晶圆级先进封测制造项目”；二期投资额为 18 亿元，其中固定资产投资 18 亿元。

本项目资金来源为公司 2023 年拟向特定对象发行 A 股股票所得募集资金、公司自有或自筹资金。若公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票未获上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会注册通过，本项目（包含一期、二期）将以自有资金或自筹资金进行。

### （二）对外投资的决策与审批程序

公司于 2023 年 10 月 27 日召开了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资意向协议

暨对外投资的议案》，同意公司、控股子公司芯成汉奇（作为晶圆级先进封测制造项目一期、二期实施主体）与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订《东莞松山湖高新技术产业开发区项目投资意向协议》，并提请股东大会授权公司管理层负责办理本项目实施及开展相关的一切事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议。

### （三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

## 二、协议主体的基本情况

名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会

性质：地方政府机构

地址：东莞市松山湖园区礼宾路1号

东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

## 三、投资标的基本情况

### （一）控股子公司的基本情况

1、子公司名称：广东芯成汉奇半导体技术有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、注册资本：500万元人民币

4、出资方式：货币出资

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；电子元器件零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；模具制造；模具销售；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；机械设备销售；半导体器件专用设备销售；包装材料及制品销售；国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、持股情况：公司持股70%

### （二）拟投资项目的的基本情况

1、项目名称：晶圆级先进封测制造项目一期、二期

2、项目实施主体：广东芯成汉奇半导体技术有限公司

3、项目投资规模：本项目总投资额约为 30.9 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），其中一期投资额约为 12.9 亿元，其中固定资产投资 12 亿元，一期项目同时作为公司向特定对象发行 A 股股票的募投项目“晶圆级先进封测制造项目”；二期投资额为 18 亿元，其中固定资产投资 18 亿元。

4、项目选址及用地：东莞市生态园兴业路与东兴西路交汇处东南侧地块

5、项目建设期：拟于 2028 年 12 月 31 日之前完成总投资额。

6、项目资金来源：资金来源为公司 2023 年拟向特定对象发行股票所得募集资金、公司自有或自筹资金

#### 四、项目投资意向协议的主要内容

##### （一）签署主体

甲方：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会

乙方：广东芯成汉奇半导体技术有限公司

丙方：深圳佰维存储科技股份有限公司

##### （二）协议主要内容

##### 1、项目概况

（1）本协议项下的项目是指乙方承诺在松山湖投资建设晶圆级先进封测制造项目（含一期、二期，下称“本项目”），从事先进封测业务。

（2）本项目投资总额约叁拾亿玖仟万元人民币（小写：¥3,090,000,000 元人民币）。项目分两期投资，一期：投资额约为壹拾贰亿玖仟万元人民币（小写：¥1,290,000,000 元），其中固定资产投资 1,200,000,000 元。二期：投资额为壹拾捌亿元人民币（小写：¥1,800,000,000 元），其中固定资产投资 1,800,000,000 元。

（3）乙方作为本项目经营实体，承担本协议项下的权利和义务。如果乙方无法履约时，丙方须对乙方违反本协议条款的行为承担补充责任，补充责任以丙方对乙方的持股比例为限。

##### 2、项目效益

乙方在固定资产投资额、工业总产值、税收贡献、研究开发费用投入、知识产权申请量、引进人才数量等方面做出一定的承诺效益。

##### 3、项目用地

本项目工业用地位于东莞市生态园兴业路与东兴西路交汇处东南侧地块，使

用年限为 50 年，乙方保证项目用地仅限于工业用途。

#### 4、项目建设

本项目建设晶圆级先进封装生产基地，包括但不限于厂房、宿舍、研发楼、食堂、动力站、污水处理站、大宗气站、室外工程等。乙方承诺在竞得本项目用地使用权之日起 3 个月内取得施工许可证并进场建设。甲方承诺在依法依规的情况下在方案审批、施工建设、报建手续上给予支持和帮助，积极协助乙方解决项目建设和投运过程中出现各种困难和问题。

#### 5、项目扶持

甲方承诺对乙方提供一定的项目扶持，包含：设备补贴、场地租金和基建补贴、金融扶持、公寓租赁补贴、三限房扶持、子女教育支持、经济贡献奖励、人才政策申请支持。

#### 6、履约监督

(1) 甲方有权指定招商部门对乙方履行本协议项下义务进行监督，并就乙方履约不当或相关违约行为适时要求乙方进行整改。

(2) 因乙方原因未按时进场建设、未按时竣工或乙方存在约定时间内项目固定资产投资额、产值中任何一项指标未能达到本协议约定条件的，甲方有权停止实施优惠政策和本项目有关奖励/扶持，并有权对已支付的相关奖励/扶持资金按照协议约定条件进行追回。但非乙方原因导致项目逾期竣工投产的，则在逾期期限内，乙方不承担违约责任，且相应考核期限顺延。

(3) 甲方有权在本协议约定时间内对乙方税收进行考核，若乙方在本协议约定时间内税收未能达到本协议约定评价标准的，甲方有权要求乙方按照协议约定支付违约金。但非乙方原因导致项目逾期竣工投产的，则在逾期期限内，乙方不承担违约责任，且相应考核期限顺延。

(4) 乙方违反协议第四条第 6 点的，若已取得项目用地使用权，甲方且有权全部购回项目地块的土地使用权及地上建筑物、附着物。购买价格计算方式如下：
$$\text{购买价格} = (\text{原土地价款} + \text{地上建筑物附着物决算造价}) \div \text{《不动产权证书》所载的土地使用年限} \times (\text{《不动产权证书》所载的土地使用年限} - \text{项目用地已出让年限})$$
甲方按本条约定提出回购要求的，乙方不得拒绝，并应在 60 日内无条件地签署相关文件及提交相关资料、配合甲方办理相关产权过户手续，移交地上建筑物、附着物的全部相关资料。

(5) 未经甲方书面同意，乙方擅自变更地块产业准入类别或改变土地用途或违反建设要求（参考协议第六条）的，乙方应按该地块土地出让金的 20%向甲方缴纳违约金。

7、因履行本协议发生争议，由争议相关方协商解决，协商不成的，提交项目所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

## 五、对外投资对公司的影响

本次投资协议的签订，将有助于打造公司晶圆级先进封测能力，满足先进存储器和大湾区市场封测需求，进一步提高核心竞争力，为未来业务增长夯实基础，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。

## 六、对外投资的风险分析

1、本次投资涉及的取得建设用地、施工等前置手续尚未办理，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；

2、本项目是基于公司战略发展的需要以及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性；本项目涉及的建设周期、产能规模等均为初步规划或预测数据，项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，最终实际实施、生产情况具有不确定性，可能存在未能按期建设完成或未能达到预期收益的风险；

3、芯成汉奇作为本项目经营实体，承担本协议项下的权利和义务。如果芯成汉奇无法履约时，公司须对芯成汉奇违反本协议条款的行为承担补充责任，补充责任以公司对芯成汉奇的持股比例为限；

4、晶圆级先进封测制造项目为公司 2023 年度拟向特定对象发行 A 股股票募投项目之一，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第三届董事会第十次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过，但尚需经上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。若公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票未获上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会注册通过，本项目（包含一期、二期）将用公司自有资金或自筹资金进行。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日